

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

合肥晶合集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称	申万菱信、宝盈基金、浙商电子、汇添富基金、光大电子、新华资产、海通证券。
会议时间	2024年1月2日-2024年1月4日
会议地点	公司会议室、线上会议
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理 黎翠綾 企业规划室协理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>问题 1、请问公司对 AR/VR 等新兴应用领域的发展有何布局？</p> <p>答复：公司针对 AR/VR 微型显示技术，正在进行硅基 OLED 技术的开发，已与国内面板领先企业展开深度合作，加速应用落地。</p> <p>问题 2、请问公司现在及未来的产能规划？</p> <p>答复：公司目前的产能为 11 万片/月，2024 年公司计划根据市场的复苏情况弹性规划扩产计划。</p> <p>问题 3、请介绍下公司新产品的研发进展？</p> <p>答复：目前公司 40nm 的 OLED 驱动芯片已经开发成功并正式流片，28nm 的产品开发正在稳步推进中。</p>

附件清单（如有）	无
日期	2024年1月4日